Baugruppen

Speicherarten (Aufbau und Wirkungsweise):

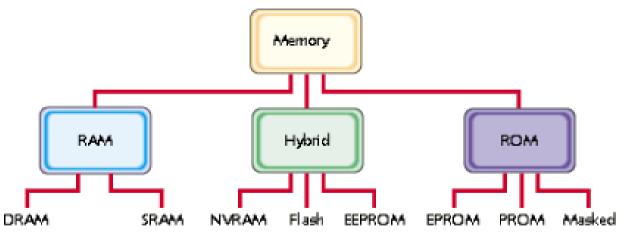


Abb.32: Gängige Speichertypen

- Speicher dient zur Aufbewahrung von Daten
- Festwertspeicher halten Daten auf Dauer (auch nach abschalten Versorgungsspannung)
- Schreib-Lesespeicher verlieren Daten nach Verlust von Versorgungsspannung

 Speicherfeld besteht aus vielen 1-Bit-Speicherelementen, die z.B. byteweise angeordnet sind

Beispiel: Bei einem Prozessor mir 32 Bit-Architektur kann ein max. Speicher von $z_s=2^n=2^{32}=4.294.967.296$ Byte = 4.194.304 KiB = 4 GiB adressiert werden. (-> bzw. Speicherzellen angewählt werden)

- Größe von Speichern bei bitweiser Speicherung mit z.B. 1 Kibit=2¹⁰ bit=1024 bit angegeben (oder bei wortweiser Speicherung z.B. 1 MiB=1.048.576 * 8 bit)
 - -> Schreib-Lese-Speicher hat (hier) 4 Adressleiter -> 2⁴ = 16 Zeilen anwählbar
 - -> Daten werden byteweise gespeichert

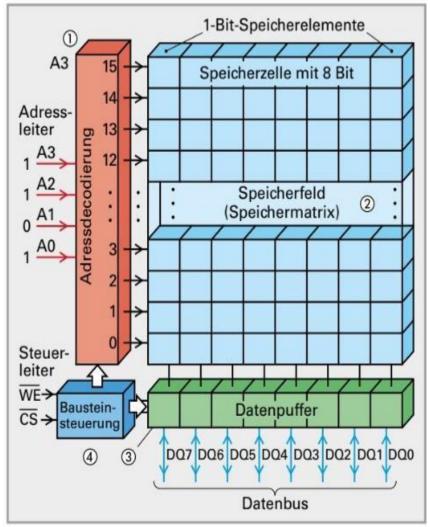


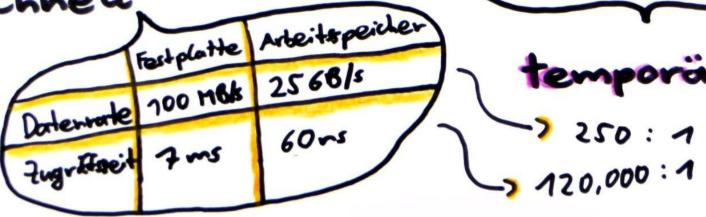
Abb.33: Aufbau Speicher

RAM (Arbeitsspeicher):

Arbeitsspeicher



- auch , Harptspeicher
- Zwischenspeichern von Daten für CPU
- schnell, Ergebnisse



RAM

- 狐
- -> random access memory
- = wahlfreier Speicher

VRAM

- volatil/flüchtig
- Speichern nur mit Stromzufuhr

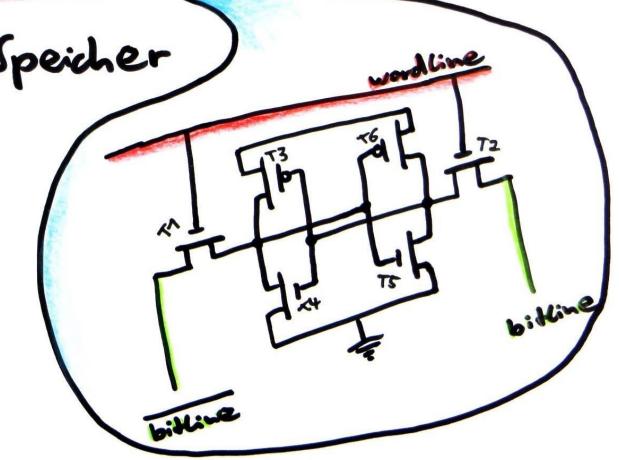
NVRAM

- night volatil/flüchtig
- Speichern ohne Strom zufuhr



- statischer Speicher

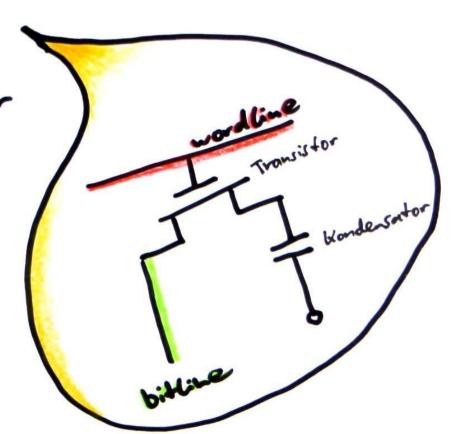
- + schnell
- + keine Auffrischung
- komplex => groß





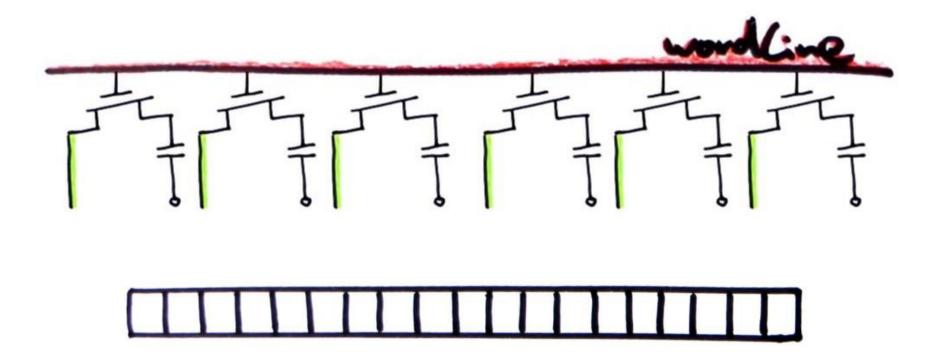
- dynamischer Speicher

- + einfach => klein
- Auffrischung
- langsam

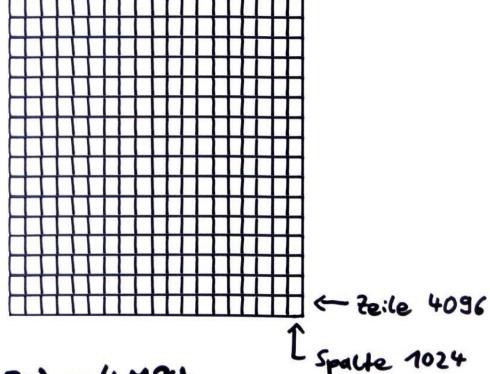


Speichgröße > Schrelligkeit => DRAM-Arteitsspeider

Speicherzeile / Page

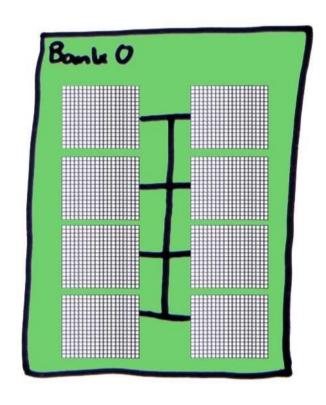


Speicherfeld

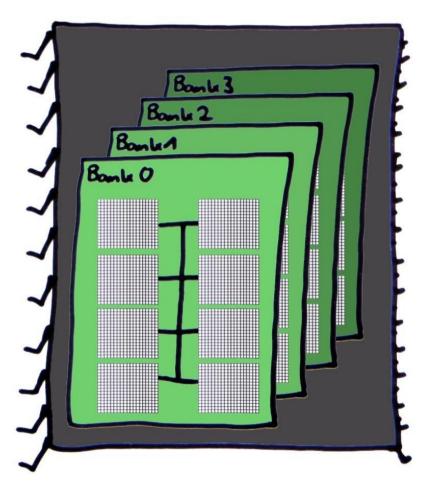


4096 Bit x 1024 Bit = 4 MBit

Speicherbank



Speicherchip



4x 32 MBit = 128 MBit

128 MBit /8 = 16 MByte

Lesen/Schreiben

- 1. Ansprechen von Ziel-Chip/Bank
- 2. Adresse + Zeilendekoder -> Zeile
- 3. Aktivieren der Speicherzeile
- 4. Advesse + Spaltendekoder -> Spalte
- 5. Datenleitung an Bitline

Ly Lesen Schreiben

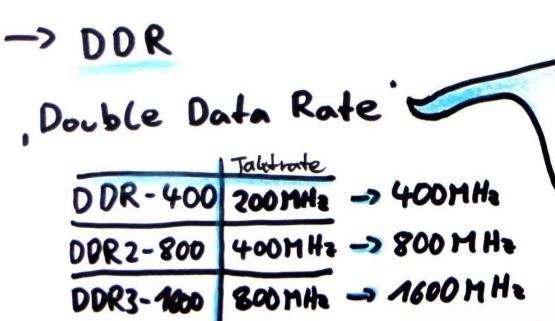
6. Dealstrieren der Speicherzeile

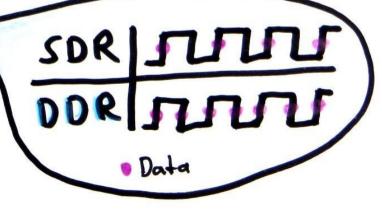
- CL oder CAS (Column Address Strobe Latency): Die Anzahl der Zyklen, die zwischen der Anforderung von Daten aus dem Speicher durch den Prozessor und der Rückgabe der Daten vergehen.
- tRCD (Row Column Delay): Die Anzahl der Zyklen, die zwischen der Aktivierung der Zeile (RAS) und der Spalte (CAS), in der die Daten in der Matrix gespeichert werden, vergehen.
- tRP (Row Precharge Time): Die Anzahl der Zyklen, die zwischen der Deaktivierung des Zugriffs auf eine Datenzeile und dem Beginn des Zugriffs auf eine andere Datenzeile vergehen.
- tRAS (Row Active Time): Wie lange der Speicher warten muss, bis die nächste Speicherzugriffsanforderung ausgelöst werden kann.

LOSDRAM

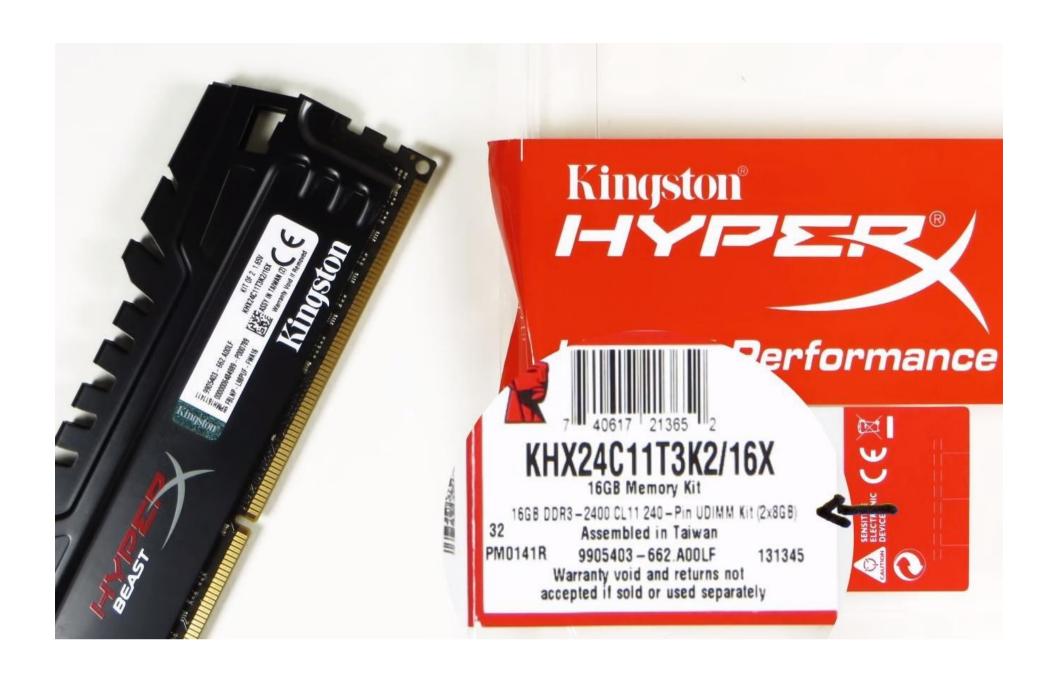
, Synchronous DRAM'

- DRAM Taktrate synchron en Systembus









ROM & Co:

Nichtflüchtiger Speicher wird für die Aspekte des Computers verwendet, die sich nicht ändern, wie beispielsweise für das anfängliche Hochfahren des Computers (BIOS) oder die Firmware-Anweisungen, die einen Drucker zum Laufen bringen.

- ROM = Read Only Memory
- Zustand einer Speicherzelle definiert durch feste Verdrahtung von Bauelementen zwischen Wort- und Bitleitungen
- Daten müssen bereits beim Herstellungsprozess berücksichtigt werden
- Vorteil: sehr kompakter Schaltungsaufbau, da optimiert auf zu speichernde Daten
- Nachteil: sehr unflexibel (für die Änderung eines Bits muss die Schaltung geändert werden) -> reine ROMs sind sehr selten

PROM:

- PROM = Programmable ROM
- Information wird "eingebrannt"
- Hierfür wird eine Maske verwendet, die für die Erzeugung der einzelnen Schichten des Chips verwendet wird
- Vorteil: flexibler wie reine ROMs, gleicher Herstellungsprozess für verschied. Chips (nur unterschiedl. Maske)
- Nachteil: Programmierung nur durch Hersteller möglich

EPROM:

- EPROM = Erasable PROM
- Spezielle Speichertransistoren (Floating-Gate-MOSFETs) repräsentieren Zustand eines Bits
- Programmierung durch spezielles Gerät
- Löschbar durch Bestrahlung mit UV-Licht (Chips ist mit lichtdurchlässigem Fenster versehen)
- Programmierzeit: 50ms
- Löschzeit: 20 Minuten
- Vorteil: Chip mehrfach nutzbar
- Nachteil: Löschen umständlich und langsam

EEPROM:

- EPROM = Electrical EPROM
- z.B. Speicherung kleiner Datenmengen in elektronischen Geräten
- Bits werden wie beim EPROM in speziellen Speichertransistoren (Floating-Gate-MOSEFETs) gesichert
- Elektronen werden elektrisch aus Speichertransistor abgesaugt
- Schreiben und Löschen erfolgt byteweise -> Chip muss nicht ausgebaut werden
- Programmierzeit: 50ms
- Löschzeit: 1ms
- Vorteil: Löschen einfacher und schneller

Flash-Speicher:

- Verwendet in Memory-Cards, Handys, Modems, BIOS, SSD, ...
- Ersatz für Festplatten und Disketten -> weniger empfindlich geg. Stöße etc.
- Kapazität bis zu 512 MB
- Speicherfähigkeit: 10-100 Jahre
- Ca. 100.000 Programmier- und Löschzyklen möglich
- Ähnlich wie ein EEPROM aufgebaut (Floating-Gate-MOSEFETs)
- Blockweiser Zugriff z.B. 512 Byte (im Gegensatz zu EEPROM) bei NAND-Technik
- Lesezugriff: ca. 100-200ns
- Block-Schreibzeit: 10-200ms
- Block-Löschzeit: 2-100ms
- Vorteile:
 - -> Sehr flexibel
 - -> Chip muss zum programmieren nicht ausgebaut werden

(-> Floating-Gate-MOSFET später bei SSD)

- einzelnen Speicherzellen bilden bei ROM-Baustein Schnittpunkte zwischen Datenleistungen und den Zeilenleitungen
 -> Diode stellt als Verbindung das High-Bit dar -> ohne Verbindung ist es Low-Bit (Abb.35)
- jede Speicherzelle (1 Bit) besteht aus Diode und einer **Schwachstelle** -> Schwachstellen werden durch Programmier-Gerät zerstört und damit 1 Bit gesetzt -> Zustand bleibt dann für immer erhalten (Abb.36)

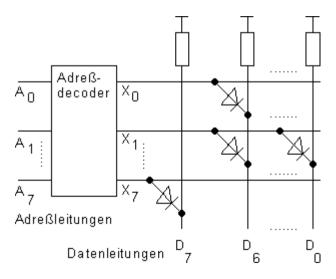


Abb.35: Aufbau ROM-Baustein

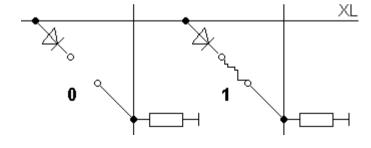


Abb.36: Aufbau PROM-Baustein